

PORTARIA INTERMINISTERIAL MDIC/MCTI Nº 10, DE 19 DE MAIO DE 2023

Altera o Processo Produtivo Básico - PPB para o produto MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE ("TOUCH SCREEN") - TABLET-PC, industrializado na Zona Franca de Manaus.

OS MINISTROS DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS e DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, no uso das atribuições que lhes confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, tendo em vista o disposto no § 6º do art. 7º do Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, no § 1º do art. 2º, art. 4º e nos arts. 11 a 18 do Decreto nº 10.521, de 15 de outubro de 2020, e considerando o que consta no processo nº 119687.110126/2022-61, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, resolvem:

Art. 1º O Processo Produtivo Básico do produto MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE ("TOUCH SCREEN") - TABLET-PC, industrializado na Zona Franca de Manaus, passa a ser composto pelas etapas e respectivas pontuações relacionadas na tabela constante do Anexo desta Portaria Interministerial.

§ 1º Os pontos totais serão atribuídos a cada etapa de produção realizada, conforme o disposto no Anexo desta Portaria, sendo que a empresa deverá acumular a pontuação mínima de 40 (quarenta) pontos por ano-calendário.

§ 2º O projeto de desenvolvimento a que se refere a etapa I do Anexo desta Portaria só será pontuado para produto que atenda às especificações, normas e padrões adotados pela legislação brasileira e cujas especificações, projetos e desenvolvimentos tenham sido realizados no País, por técnicos de comprovado conhecimento em tais atividades, residentes e domiciliados no Brasil e atendam às Portarias específicas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

§ 3º Quando a placa que implemente a função de processamento central contar adicionalmente com função de interface de comunicação descrita na etapa IX do Anexo desta Portaria, a meta de 40 (quarenta) pontos estabelecida no §1º deste artigo passará a ser de 34 (trinta e quatro) pontos.

Art. 2º O investimento em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Adicional (PD&IA) ao exigido pela legislação a que se refere a etapa II do Anexo desta Portaria deverá ser aplicado, na Amazônia Ocidental ou no Estado do Amapá, em programas e projetos de interesse nacional nas áreas de tecnologias da informação e comunicação considerados prioritários pelo Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia - CAPDA.

§ 1º O investimento a que se refere o caput deste artigo deverá ser calculado sobre o faturamento bruto no mercado interno, decorrente da comercialização com fruição do benefício fiscal, do produto a que se refere esta Portaria, deduzidos os tributos incidentes nesta operação.

§ 2º A comprovação do investimento em PD&IA deverá ser apresentada de forma discriminada junto com o relatório descritivo referente à obrigação estabelecida na Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991.

§ 3º Para efeito do disposto no caput deste artigo, serão considerados como aplicação em atividades de PD&IA do ano-calendário os dispêndios correspondentes à execução de tais atividades realizadas até 31 de março do ano subsequente.

Art. 3º Sempre que fatores técnicos ou econômicos, devidamente comprovados, assim o determinarem, a realização de qualquer etapa do Processo Produtivo Básico poderá ser suspensa temporariamente ou modificada por meio de portaria conjunta dos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Art. 4º Fica revogada a Portaria Interministerial SEPEC/ME/MCTIC nº 7, de 26 de junho de 2019.

Art.5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.



ANEXO

Etapa	Descrição da etapa produtiva	Pontos Totais
I	Projeto de Desenvolvimento no País - Portaria MCT nº 950, de 12 de dezembro de 2006, ou Portaria MCTIC nº 1.309, de 19 de dezembro de 2013, ou Portaria MCTIC nº 356, de 19 de janeiro de 2018, ou Portaria MCTIC nº 3.303, de 25 de junho de 2018, ou Portaria MCTI nº 4.514, de 2 de março de 2021.	8
II	Investimento em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Adicional (PD&IA), valendo 2 pontos para cada 1% investido, limitado a 6 pontos.	6
III	Desenvolvimento do software embarcado de baixo nível (firmware) da placa de processamento principal.	2
IV	Corte do wafer, encapsulamento e teste dos Processadores Principais, ou corte do substrato, encapsulamento e teste dos Componentes Semicondutores de Alta Integração System in Package - SiP com função de Processamento Central.	10
V	Laminação e corte das placas de vidro e encapsulamento da célula de vidro polarizada para tela de cristal líquido (LCD).	16
VI	Injeção, moldagem ou outro processo de conformação (impressão 3D) ou estampagem das carcaças dos gabinetes.	4
VII	Furação, transferência de imagem, corrosão, acabamento mecânico e teste elétrico da placa de circuito impresso que implemente a função de processamento central.	4
VIII	Montagem e soldagem de todos os componentes na placa que implemente a função de processamento central.	9
IX	Montagem e soldagem de todos os componentes na placa que implemente a função de interface de comunicação, quando não integrada à placa principal.	6
X	Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas que implementem a função de acesso à rede celular, quando não integrada à placa principal.	6
XI	Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas que implementem a função de conversores CA/CC, com o enrolamento das bobinas ou inserção e soldagem dos pinos nas placas multicamadas dos transformadores.	7
XII	Decapagem e crimpagem dos cabos de dados.	4
XIII	Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de controle e integração com as células de carga dos acumuladores elétricos.	9
XIV	Corte do wafer e encapsulamento e teste dos circuitos integrados de memória.	16
XV	Integração final.	5
XVI	Testes.	1
	TOTAL	113
	META	40

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

